



# PowerEdge R770AP

## Skalierbare Rechenleistung für Enterprise-Innovationen

Der Dell PowerEdge R770AP wurde entwickelt, um anspruchsvolle Enterprise-Workloads nach Maß zu konsolidieren. Mit hoher Rechenkapazität, erweiterter Arbeitsspeicherbandbreite und sicherem Lebenszyklusmanagement unterstützt er umfangreiche Virtualisierung, erfolgskritische Datenbanken, Analysen und KI-gesteuerte Anwendungen – alles mit der bewährten Zuverlässigkeit von PowerEdge.

## Hauptvorteile

### Unübertroffene Compute-Dichte

- Bis zu 2 Intel® Xeon® 6 Prozessoren der 6900 Serie mit jeweils bis zu 128 P-Cores
- Unterstützt Tausende gleichzeitiger NutzerInnen, Echtzeitanalysen und Hochleistungssimulationen

### Erweiterte Arbeitsspeicher- und Storage-Architektur

- 12 DDR5-DIMMs pro Sockel (bis zu 3 TB und 6400 MT/s)
- Bis zu 16 2,5-Zoll-NVMe-Laufwerke mit PCIe Gen 5.0
- Bis zu 32 E3.S-NVMe-Laufwerke mit PCIe Gen 5.0
- Bietet 1,87-fach schnellere Zugriffe auf den Arbeitsspeicher und bis zu 2-fach höhere Storage-Bandbreiten im Vergleich zu vorherigen Generationen

### Flexible Erweiterung und Konnektivität

- Bis zu 5 PCIe Gen-5.0-Steckplätze plus zwei OCP NIC 3.0
- Schnelle Server-zu-Server-Kommunikation und einfache Skalierung sich entwickelnder Workloads

### Sicheres vereinfachtes Management

- Hardwarebasierte Silicon Root of Trust und kryptografisch signierte Firmware
- Systemsperre und selbstverschlüsselnde Laufwerke für Data-at-Rest-Schutz
- iDRAC und OpenManage bieten ein sicheres End-to-End-Lebenszyklusmanagement

### Entwickelt für nachhaltige Effizienz

- Optimiert für erweiterte Luftkühlung mit Unterstützung für effizientes Energiemanagement
- Niedrigere Betriebskosten bei gleichzeitiger Unterstützung eines nachhaltigen Rechenzentrumswachstums

### Gründe für PowerEdge R770AP

Durch die Kombination hoher Core-Dichte, erweiterter Arbeitsspeicherbandbreite und vertrauenswürdiger PowerEdge-Ausfallsicherheit ist der R770AP speziell für Unternehmensumgebungen entwickelt, die sowohl Performance als auch Ausfallsicherheit erfordern. Er bietet die erforderliche Skalierung, um enorme Workloads auszuführen, die Effizienz zum Senken der Betriebskosten und die Sicherheit zum Schutz kritischer Daten. Dadurch wird er zur Serverbasis für Enterprise-Innovationen.

Dieses Dokument enthält eine umfassende Liste der Produktfunktionen. Funktionen, die mit einem Sternchen (\*) gekennzeichnet sind, sind jedoch möglicherweise bei der Einführung nicht verfügbar, werden aber in zukünftigen Updates eingeführt. Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit oder der Veröffentlichungszeitplan einer Funktion in diesem Dokument nicht bestätigt wird. Die genauesten und aktuellsten Informationen zur Verfügbarkeit von Funktionen finden Sie auf der Produktkonfiguratorseite unter [dell.com](https://www.dell.com).

Funktion	Technische Daten	
Prozessor	Zwei Intel® Xeon® 6 Prozessoren der 6900 Serie mit P-Cores und jeweils bis zu 128 Cores.	
Speicher	<ul style="list-style-type: none"> <li>24 DDR5 DIMM-Steckplätze, RDIMM mit max. 3 TB, Geschwindigkeiten von bis zu 6.400 MT/s</li> <li>Unterstützt nur registrierte ECC DDR5-DIMMs</li> </ul> Hinweis: Der installierte Prozessor kann die Betriebsgeschwindigkeit des DIMM verringern	
Storage-Controller	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interne Controller (RAID): PERC H975i DC-MHS vorn</li> <li>Externe Controller: k. A.</li> <li>Internes Bootsystem: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS): HWRaid 1, 2 x M.2 NVMe-SSDs oder USB</li> </ul>	
Laufwerkschächte	Vordere Schächte: <ul style="list-style-type: none"> <li>Konfiguration ohne Rückwandplatine</li> <li>Bis zu 16 x 2,5-Zoll-NVMe G5 x4 (SSD), max. 245,76 TB</li> <li>Bis zu 16 x 2,5-Zoll-NVMe G5 x2 (SSD), max. 245,76 TB</li> <li>Bis zu 32 x EDSFF E3.S Gen5-NVMe (SSD), max. 491,52 TB</li> </ul> Anschlüsse auf der Rückseite: k. A.	
Netzteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.500 W Titanium 100 bis 120 LLAC oder 200 bis 240 HLAC, 240 VDC, Hot-Swap-fähig, redundant</li> <li>1800 W Titanium, 200 bis 240 HLAC, 240 VDC, Hot-Swap-fähig, redundant</li> <li>2400 W Titanium 100 bis 120 LLAC oder 200 bis 240 HLAC, 240 VDC, Hot-Swap-fähig, redundant</li> <li>3200 W Titanium 200 bis 220 HLAC oder 220,1 bis 240 HLAC, 240 VDC, Hot-Swap-fähig, redundant</li> <li>3200 W Titanium 277 Vac und HVDC, Hot-Swap-fähig, redundant</li> </ul>	
Kühlungsoptionen	Luftkühlung	
Lüfter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bis zu 6 Hot-Swap-fähige Lüfter</li> </ul>	
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Höhe: 86,8 mm (3,42 Zoll)</li> <li>Breite: 482 mm (19,0 Zoll)</li> <li>Tiefe: 802,40 mm (31,59 Zoll) mit Blende</li> <li>Tiefe: 801,51 mm (31,56 Zoll) ohne Blende</li> </ul>	
Bauweise	2-HE-Rack-Server	
Integriertes Management	<ul style="list-style-type: none"> <li>iDRAC10</li> <li>iDRAC Direct</li> <li>iDRAC RESTfull API mit Redfish</li> <li>RACADM-CLI</li> <li>iDRAC Service Module</li> </ul>	
Blende	Optionale Metallblende	
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kryptografisch signierte Firmware</li> <li>Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement)</li> <li>Secure Boot</li> <li>Gesicherte Komponentenverifizierung (Hardwareintegritätsprüfung)</li> <li>Secure Erase</li> <li>Silicon Root of Trust</li> <li>Systemsperrung (iDRAC10 Enterprise oder Datacenter erforderlich)</li> <li>TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert</li> <li>Gehäuseeingriffserkennung</li> </ul>	
OCP-Netzwerkoptionen	Bis zu zwei OCP-NIC-Karten 3.0 <ul style="list-style-type: none"> <li>Steckplatz 4: 1 x8 oder 1 x16 Gen5 OCP 3.0</li> <li>Steckplatz 10: 1 x16 Gen5 OCP 3.0</li> </ul>	
Integriertes NIC	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Gb dedizierter BMC-Ethernetanschluss</li> </ul>	
GPU-Optionen	k. A.	
Anschlüsse	Frontschnittstellen <ul style="list-style-type: none"> <li>1 USB 2.0 Typ C-Anschluss</li> </ul>	Anschlüsse auf der Rückseite <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x dedizierter BMC-Ethernetanschluss</li> <li>2 x USB 3.1 Typ-A-Anschlüsse</li> <li>1 x VGA</li> </ul>
	Interne Anschlüsse <ul style="list-style-type: none"> <li>1 USB 3.1-Typ-A-Anschluss</li> </ul>	
PCIe	Bis zu 5 Gen5 PCIe-Steckplätze (x16-Anschlüsse) <ul style="list-style-type: none"> <li>Steckplatz 2: 1 x16 Gen5 (x16-Anschluss), volle Höhe, halbe Länge</li> <li>Steckplatz 3: 1 x16 Gen5 (x16-Anschluss), volle Höhe/flaches Profil, halbe Länge</li> <li>Steckplatz 9: 1 x16 Gen5 (x16-Anschluss), volle Höhe/flaches Profil, halbe Länge</li> <li>Steckplatz 7: 1 x16 Gen5 (x16-Anschluss), volle Höhe, halbe Länge</li> <li>Steckplatz 5: 1 x16 Gen 5 (x16-Anschluss), volle Höhe, halbe Länge</li> </ul>	
Betriebssystem und Hypervisors	<ul style="list-style-type: none"> <li>Canonical Ubuntu Server LTS</li> <li>Red Hat Enterprise Linux</li> <li>SUSE Linux Enterprise Server</li> <li>VMware vSAN / VMware ESXi*</li> <li>Microsoft Windows</li> <li>Microsoft Windows Server</li> <li>Microsoft Windows Server Datacenter</li> </ul> Technische Daten und Details zur Interoperabilität finden Sie unter <a href="https://www.dell.com/ossupport">Dell.com/OSsupport</a> .	
OEM Ready-Version erhältlich	Von der Blende über das BIOS bis hin zur Verpackung – Ihre Server können aussehen wie von Ihnen entworfene und gefertigte Produkte. Weitere Informationen erhalten Sie unter <a href="https://www.dell.com/oem">Dell.com/OEM</a> .	

\* Funktion bei Produkteinführung nicht verfügbar. Informationen zur Verfügbarkeit der Funktionen finden Sie auf der Produktkonfiguratorseite unter Dell.com.

**Hinweis:** Von der Blende über das BIOS bis hin zur Verpackung: Ihre Server können aussehen wie von Ihnen entworfene und gefertigte Produkte, dank unserer OEMR-Plattformen. Die XL-Plattformen bieten erweiterte Übergänge und Stabilität für NutzerInnen von OEM Solutions. Weitere Informationen finden Sie unter Dell.com -> Solutions -> OEM Solutions.

## Dell APEX on Demand

Dell APEX Flex on Demand Erwerben Sie die Technologie, die Sie benötigen, um Ihre wechselnden Unternehmensanforderungen mit Zahlungen zu unterstützen, die an die tatsächliche Nutzung angepasst sind. Weitere Informationen finden Sie unter

[www.delltechnologies.com/de-de/payment-solutions/flexible-consumption/flex-on-demand.htm](http://www.delltechnologies.com/de-de/payment-solutions/flexible-consumption/flex-on-demand.htm).

**HINWEIS:** „Dieses Dokument enthält eine umfassende Liste der Produktfunktionen. Funktionen, die mit einem Sternchen (\*) gekennzeichnet sind, sind jedoch möglicherweise bei der Einführung nicht verfügbar, werden aber in zukünftigen Updates eingeführt. Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit oder der Veröffentlichungszeitplan einer Funktion in diesem Dokument nicht bestätigt wird. Die genauesten und aktuellsten Informationen zur Verfügbarkeit von Funktionen finden Sie auf der Produktkonfiguratorseite unter dell.com.

Erfahren Sie mehr über PowerEdge-Server.



Weitere Informationen  
zu Services für  
PowerEdge-Server



Erfahren Sie mehr  
zu unseren Systems  
Management-Lösungen



Durchsuchen Sie unsere  
Ressourcenbibliothek



Folgen Sie  
Dell Technologies  
auf X (ehemals Twitter)



Wenden Sie sich an  
einen Dell Technologies  
Experten für [Vertrieb](#)  
oder [Support](#)